

# ハロゲンフリー ソルダーペースト

## Halogen-Free Solder Paste

### LFSOLDER TLF-204-NH

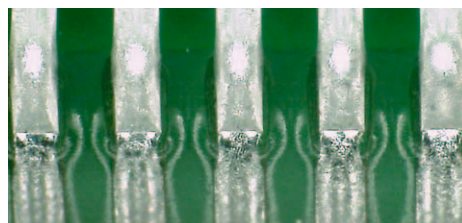
優れたぬれ性と耐熱性!  
Excellent Wettability and Heat-Resistance!

SGSデータ SGS data

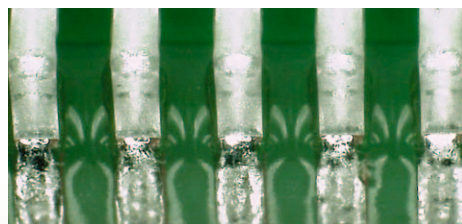
SGS				
Test Report		No. CANEC0802536001	Date: 26 May 2008	Page 2 of 3
Test Results:				
ID for specimen 1	:	CAN08-025360.001		
Description for specimen 1	:	Brown paste		
Halogen				
Test Item(s)	Unit	Test Method (Reference)	Result	MDL
Fluorine (F)	mg/kg	BS EN 14582:2007, IC	N.D.	50
Chlorine (Cl)	mg/kg	BS EN 14582:2007, IC	N.D.	50
Bromine (Br)	mg/kg	BS EN 14582:2007, IC	N.D.	50
Iodine (I)	mg/kg	BS EN 14582:2007, IC	N.D.	50
Note:				
1. mg/kg = ppm				
2. N.D. = Not Detected (< MDL)				
3. MDL = Method Detection Limit				

QFP端面へのぬれ上がり Wetting of QFP lead ends

N<sub>2</sub>リフロー  
N<sub>2</sub> Reflow



大気リフロー  
Air Reflow



## 特長

- フラックスにハロゲン系化合物を使用しておりません。
- 連続印刷時の経時変化が少なく、優れた連続印刷安定性を示します。
- 大気リフローにおいてもはんだ付性が良好です。
- 鉛フリーに適合した高温プロファイルにおいても優れたはんだ付性を示します。

## FEATURES

- Does not use a halogen compound in the fluxes.
- Stable printability with little change in viscosity when printing continuously.
- Excellent solderability even in air reflow.
- Excellent solderability at high temperature.

## 一般特性 General Properties

項目	ITEM	TLF-204-NH	試験方法 Test method
合金組成	Alloy Composition	Sn / 3.0Ag / 0.5Cu	JIS Z 3282 (1999)
融点	Melting Point (°C)	216 / 220	DSC測定 DSC measurement
はんだ粉末の粒度	Particle Size of Solder Powder (μm)	25~41	レーザー解析 Laser analysis
フラックス含有量	Flux Content (%)	12.0	JIS Z 3284 (1994)
塩素含有量	Chlorine Content (%)	0.0	JIS Z 3197 (1999)
粘度	Viscosity (Pa·s)	210	JIS Z 3284 (1994)
チクソトロピー指数	Thixotropy Index	0.55	JIS Z 3284 (1994)